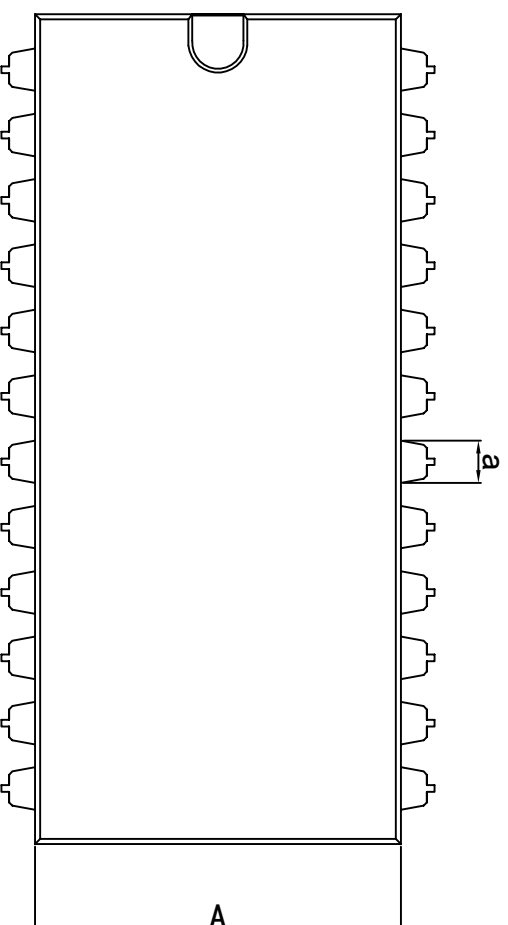
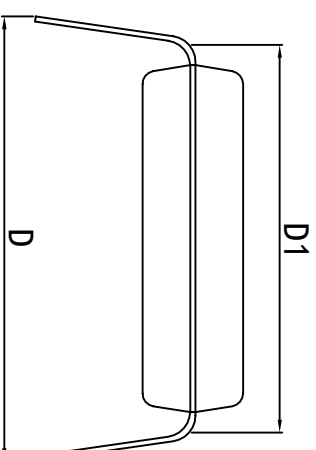
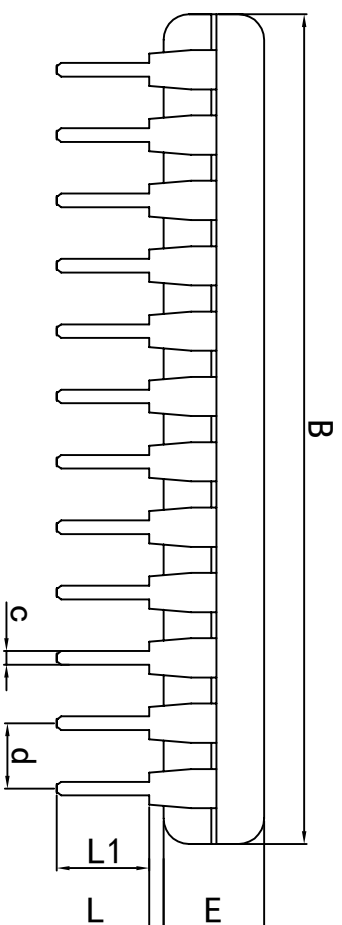




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



UNITT: mm

DIM.	A	B	D	D1	E	L	L1	a	C	d
MIN	13.21	31.24	16.00	14.99	3.71	0.38	3.00	1.45	0.38	2.54
MAX	14.22	32.26	17.28	15.49	3.91	0.55	3.60	1.65	0.53	BSC

制图 赖谊成

审阅 罗云龙

核准 林钟涛

DIP24
(600MIL)

文件名称:
HG-DIP24(600MIL)

文件编号:
HGWXT-230046

版本 V1.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-30

图纸幅面 A4



第一角法